

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局

(43) 国際公開日  
2020年3月19日(19.03.2020)



(10) 国際公開番号

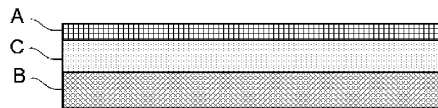
WO 2020/053949 A1

- (51) 国際特許分類:  
H01L 21/683 (2006.01) C09J 11/06 (2006.01)  
C09J 7/20 (2018.01) C09J 133/00 (2006.01)  
C09J 7/38 (2018.01) H01L 21/56 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2018/033579
- (22) 国際出願日: 2018年9月11日(11.09.2018)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (71) 出願人: 三井化学東セロ株式会社  
(MITSUI CHEMICALS TOHCELLO, INC.) [JP/  
JP]; 〒1018485 東京都千代田区神田美  
土代町7 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 栗原 宏嘉 (KURIHARA Hiroyoshi);  
〒4570801 愛知県名古屋市南区丹後通2-1  
三井化学東セロ株式会社内 Aichi (JP). 五十  
嵐 康二 (IGARASHI Kouji); 40211 デュッセル  
ドルフ オストシュトラッセ 34 三井化学ヨ  
ーロッパ有限会社内 Duesseldorf (DE).
- (74) 代理人: 速水 進治 (HAYAMI Shinji); 〒1410031  
東京都品川区西五反田7丁目9番2号 K  
DX五反田ビル9階 Tokyo (JP).

- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保  
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ,  
BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,  
CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO,  
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,  
HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH,  
KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,  
MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,  
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,  
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,  
SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,  
UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保  
護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS,  
MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM,  
ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ,  
TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ,  
DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT,  
LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS,  
SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM,  
GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(54) Title: ADHESIVE FILM AND METHOD FOR MANUFACTURING ELECTRONIC DEVICE

(54) 発明の名称: 粘着性フィルムおよび電子装置の製造方法



50

(57) Abstract: This adhesive film (50) is used for provisionally securing an electronic component when sealing the electronic component with a sealant in a manufacturing step for an electronic device, the film comprising: an adhesive resin layer (A) for provisionally securing the electronic component; an adhesive resin layer (B) used for affixing to a support substrate and having an adhesive force decreased by external stimulation; and an intermediate layer (C) disposed between the adhesive resin layer (A) and the adhesive resin layer (B). The storage elastic modulus  $E'$  of the intermediate layer (C) at 120 °C is at least  $1.0 \times 10^5$  Pa and no more than  $8.0 \times 10^6$  Pa, and the loss tangent ( $\tan \delta$ ) of the intermediate layer (C) at 120°C is no more than 0.1.

(57) 要約: 本発明の粘着性フィルム(50)は、電子装置の製造工程において封止材により電子部品を封止する際に上記電子部品を仮固定するために用いられる粘着性フィルムであって、上記電子部品を仮固定するための粘着性樹脂層(A)と、支持基板に貼り付けるために用いられ、かつ、外部刺激により粘着力が低下する粘着性樹脂層(B)と、粘着性樹脂層(A)と粘着性樹脂層(B)との間に設けられた中間層(C)と、を備え、中間層(C)の120°Cにおける貯蔵弾性率 $E'$ が $1.0 \times 10^5$  Pa以上 $8.0 \times 10^6$  Pa以下であり、かつ、中間層(C)の120°Cにおける損失正接( $\tan \delta$ )が0.1以下である。

[続葉有]

WO 2020/053949 A1

添付公開書類：

一 国際調査報告（条約第21条(3)）